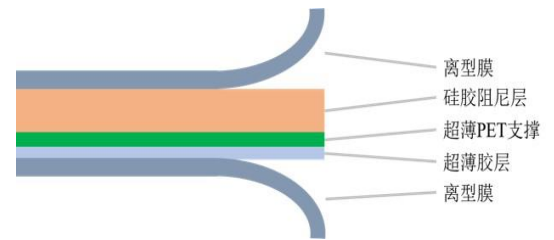


DS-H 系列阻尼硅胶片

DS-H 系列阻尼硅胶片是经过专门开发的硅胶产品，它具有阻尼效果好、加工和使用方便、硅胶表面自带高粘性等特点，可以填充狭小的空间。硅胶表面粘性可以与被贴物物理粘合，保证阻尼路径；其优秀的粘弹性可以有效的将部分机械振动或者声能以内能的方式消耗掉，降低振动振幅，从而达到阻尼的目的。DS-H 系列硅胶阻尼片可以提供不同厚度的卷材，易于加工成所需的尺寸。

特性和优势

- 材料的粘弹特性会帮助设备降低噪音和振动。
- 硅胶面具有高粘性，适用于低表面能的界面粘贴。
- 粘性随时间延长增加到较高的稳定值，防止产品脱落失效。
- 低分子硅氧烷挥发量少，可避免触电故障和光学模糊等现象。
- 丰富的厚度选择，可以满足不同间隙空间的填充。
- 不同的软硬度调节，满足各种使用要求。



应用

- 振动衰减
- 噪音隔离
- 缓冲保护

安装

- 单面背胶，方便粘贴在不同表面上。

DS -H 系列基本性能

基本性能	测试方法	典型值
厚度 (mm) 公差	厚度规	0.3mm ±10%
颜色	目测	透明主体/黑色底膜
*压缩反弹应力(kPa)	压缩速度 5mm/min. 25%compression	1400~1600
硅胶面粘着力, 180 度剥离 (gf/25mm)	对雾面 PET(内部暂定)	150~350gf/25mm
自带丙烯酸胶粘性	ASTM D1000, 180 度剥离, 对不锈钢板	>600gf/25mm
损耗因子 tanδ	扫描-40~90°C, 频率 30Hz, 剪切模式	> 0.3 (max: 0.59)
冲击吸收率	小球跌落: 铜球 30g, 高度 30cm	> 30%
低分子硅氧烷 (ppm)	内部标准	Total D ₃ ~D ₁₀ : < 800
保质期	自生产日起	12 个月

* 指厚度 0.3mm 样品的压缩反弹应力。